■第11回電子デバイスフォーラム京都プログラム（KM-1 挨拶・基調講演：西地区4号館地下1階 バズホール、KM-2、A～Eコース：東地区1号館）

（敬称略）

10月31日(木)10:00-12:30

KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:30
（受付・ウエルカムコーヒー 9:30 開始）

司会：中村 孝(大阪大学)

◆来賓挨拶
京都府知事 （予定）
京都市長 （予定）

◆基調講演
「電子デバイス産業は異次元の成長段階に突入したのだ！！
～シリコン列島ニッポンによる新たな国おこし～」
㈱産業タイムズ社 取締役会長 泉谷 渉

◆基調講演
「先端技術総合研究所における研究戦略」
三菱電機㈱ 先端技術総合研究所 副所長 西沢 昭則

◆基調講演：
「半導体製造装置業界の役割と将来への成長に向けて」
東京エレクトロン㈱ 経営戦略室 室長 西村 和哲

11月1日(金)9:20-11:45

KM-2 マーケティングセッション 9:20-11:45 （受付 8:50 開始）

司会：松下晋司(産業タイムズ社)

◆特別講演
「生成AIが牽引し再成長に向かう半導体・装置・電子部品業界」
㈱産業タイムズ社 大阪支局 支局長
電子デバイス産業新聞 副編集長 中村 剛

◆特別講演
「2025年度以降のグローバル市場動向と注目すべき半導体市場の今後の見通し」
インフォーマインテリジェンス合同会社
シニアコンサルティングディレクター 南川 明

◆特別講演
「フラットパネルディスプレイ・CMOSセンサ業界、スマホなど完成品業界見通し：25年、AI機能がスマホやPC買換えを牽引する？技術変化や今後の注目点は何か？」
みずほ証券㈱ エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ/ シニアアナリスト 中根 康夫

コース

【A】環境エネルギー

10月31日(木)14:00-16:40

A-1 環境エネルギー総論
戸所義博(イーセップ)/山崎治(シャープフロンティアAT)

◆我が国のグリーントランスフォーメーションの加速に向けて
経済産業省GXグループ GX推進企画室 高島 大樹
◆積水化学工業が進めるフィルム型ペロブスカイト太陽電池の製品開発状況と社会実装に向けた検討
積水化学工業㈱ PVプロジェクト ヘッド 森田 健晴
◆カーボンニュートラルに向けた自動車技術に関する将来展望
早稲田大学 名誉教授
研究院 次世代自動車研究機構研究所 顧問 大聖 泰弘

11月1日(金)12:35-14:50

A-2 カーボンリサイクル
松浦正純(FLOSFIA)/山崎治(シャープフロンティアAT)

◆カーボンリサイクルにおける「はかる」技術
㈱堀場製作所 エネルギー・環境本部
エネルギー・環境戦略室 室長 池田 輝彦
◆CO2を炭素源とするカーボンリサイクル型SiC合成
東北大 大学院工学研究科 応用化学専攻 助教 福島 潤
◆暮らしや産業を変えないカーボンニュートラル化を目指したSOECメタネーションによる"e-メタン革命"への挑戦
大阪ガス㈱ エグゼクティブフェロー エネルギー技術研究所
SOECメタネーション開発室 統括室長 大西 久男

11月1日(金)15:15-17:30

A-3 パワーエレクトロニクス
佐藤高史(京都大学)/中村孝(大阪大学)

◆パワーエレクトロニクス機器の高効率・高電力密度進化を支える回路技術とモデルベース技術
三菱電機㈱ 先端技術総合研究所 モータ駆動システム技術部
推進電力変換技術グループ 主席研究員 近藤 亮太
◆電力網強化のためのSiC半導体技術
(一社)SiCアライアンス 監事 東京工業大学名誉教授 嶋田 隆一
◆車両分解により見えてきた日米欧中のxEVの現在地と2030年へ向けて半導体が執るべき技術戦略
名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授 山本 真義

【B】新世代デジタル

10月31日(木)14:00-16:40

B-1 DX総論
浦岡行治(NAIST)/酒井滋樹(日新イオン機器)

◆生成AIが可能にする新しいDX：医療現場の事例
奈良先端科学技術大学院大学 教授 荒牧 英治
◆メタバース市場拡大と最新のビジネス(仮題)
クラスター㈱ 取締役 COO 成田 暁彦
◆電子デバイス業界におけるDXの進化とデータプラットフォームの役割
AOSテクノロジーズ㈱ 代表取締役社長 佐々木 隆仁

11月1日(金)12:35-14:50

B-2 次世代通信
妹尾和則(NTT研究所)/松村善夫(パナソニック)

◆シリコンフォトニクスを用いた広温度動作・高信頼光集積トランシーバ
アイオーコア㈱ 光技術統括部長 中村 隆宏
◆光電融合パッケージ技術の最新動向
国立研究開発法人産業技術総合研究所
プラットフォームフォトニクス研究センター 総括研究主幹 天野 建
◆次世代無線通信への Analog Radio over Fiber技術応用に関する村田製作所の取り組み
㈱村田製作所 技術・事業開発本部
次世代通信事業推進課 シニアリサーチャー 西田 賢

11月1日(金)15:15-17:30

B-3 AI
加藤千晴(村田製作所)/

◆アダプティブAIについて(仮題)
㈱レベリング 代表取締役社長 柳谷 智宣
◆組み込みAIの技術動向と電力効率10倍を実現するルネサスのAIアクセラレータ(DRP-AI)の御紹介
ルネサスエレクトロニクス㈱ エンベデッドプロセッシングプロダクトグループ
エンベデッドプロセッシング第一事業部 主管技師 野瀬 浩一
◆エッジAIの社会実装における現実と可能性
㈱村田製作所 通信モジュール事業部
コネクティビティモジュール開発部 戦略企画課 マネージャー 飯塚 雄彦

【C】The 半導体

10月31日(木)14:00-16:40

C-1 半導体の市場・技術動向
三冨士道彦(ローム)/廣田良浩(ワイドヴィル)

◆シリコン＆化合物パワー半導体の技術動向・市場動向
九州大学 システム情報科学研究院
価値創造型半導体人材育成センター 教授 寺島 知秀
◆デバイス視点からシステム思考へ
～GaNデバイス普及の課題と新ビジネスモデル～
ローム㈱ LSI事業本部 電源LSI事業担当
パワーステージ商品開発部 統括課長 吉持 賢一
◆半導体技術革新と環境負荷低減の共創に向けた
東京エレクトロンの環境戦略 「E-COMPASS」
東京エレクトロン㈱ テクノロジービジョン＆ストラテジー部
環境技術戦略Gr. グループリーダー 梶 公智

11月1日(金)12:35-14:50

C-2 装置技術・プロセス技術
森義弘(SCREEN)/廣田良浩(ワイドヴィル)

◆次世代デバイスを支える成膜技術動向
東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ㈱
事業開発企画室 室長 柴田 哲弥
◆先端半導体プロセスを支えるCMP装置と技術
㈱荏原製作所 技術・知的財産統括部 技監 檜山 浩國
◆AIで切り拓く先端欠陥検査技術の開発
㈱SCREENアドバンストシステムソリューションズ
開発部 開発担当課長 岡山 敏之

11月1日(金)15:15-17:30

C-3 デバイス技術・応用
山本浩之(マイクロン)/森義弘(SCREEN)

◆Innovations and Challenges in the latest DRAM
マイクロンメモリジャパン㈱
DIRECTOR,DRAM Integration Technology 藤田 博丈
◆強誘電体と酸化物半導体による次世代メモリデバイスの動向
東京大学 工学系研究科附属
システムデザイン研究センター(d.lab) 准教授 小林 正治
◆半導体設計でのEDAツールにおけるAIとマシンラーニングの状況とこれから～設計のAI化は設計者不足を解消するのか！？～
日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
アカウント・テクニカル・エグゼクティブ ディレクター 牧井 徹

【D】跳躍の最先端パッケージ・実装技術

10月31日(木)14:00-16:40

D-1 最新のパッケージ・実装技術動向
森川泰宏(ULVAC)/藤原健典(東レ)

◆チップレットパッケージの多様化とアプリケーションへのマッチング
㈱SBRテクノロジー 代表取締役 西尾俊彦
◆3D積層CMOSイメージセンサの進化と将来
ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱
第2/第4研究部門 部門長
Corporate Distinguished Engineer 岩元 勇人
◆Process Challenges for High Bandwidth Memory(HBM)
マイクロンメモリジャパン㈱ Technology Development
Process Development Sr Manager,BEOL 横井 直樹

11月1日(金)12:35-14:50

D-2 光通信デバイス
森川泰宏(ULVAC)/不破保博(元ローム)

◆Co-package optics から光電融合に向けた
光インターフェースの最新動向
一般財団法人 光産業技術振興協会 開発部 部長代理 杉立 厚志
◆シリコンフォトニクスと薄膜転写による異種材料集積
国立研究開発法人産業技術総合研究所
プラットフォームフォトニクス研究センター
シリコンフォトニクス研究チーム 主任研究員 高 磊
◆コンピュータ機器におけるPCI Express光伝送の技術動向
京セラ㈱ 先進マテリアルデバイス研究所
伝送デバイス開発部 光電モジュール課責任者 赤星 知幸

11月1日(金)15:15-17:30

D-3 高密度実装
不破保博(元ローム)/藤原健典(東レ)

◆シリコン・異種材料同時研削技術の開発とシリコン貫通電極ウェーハ加工への応用
㈱岡本工作機械製作所 技術開発本部 ナノプロセス技術部
要素プロセス開発課 課長 三井 貴彦
◆Wafer/Panel-Level Packaging分野におけるガラス素材の可能性―LPKF LIDE®技術のご紹介―
LPKF Laser & Electronics ㈱ セールスダイレクター 上舘 寛之
◆次世代高密度パッケージにおける実装技術動向
東レエンジニアリング㈱ メカトロファインテック事業本部
第一事業部 営業部 営業技術 T 主任部員 河村 知範

【E】特別セッション

10月31日(木)14:00-16:40

E-1 大学セッション(無料) マテリアル先端リサーチインフラ
土屋智由(京都大学)/向井雅昭(京都工芸繊維大学)

◆フレキシブルエレクトロニクスの研究開発と社会実装
～脳波センシングとAIが生み出す医療・ヘルスケアの可能性～
大阪大学 産業科学研究所 教授 関谷 毅
◆物理界面接合技術を駆使した先端デジタルスキンデバイスの開発
山形大学大学院 有機材料システム研究科 准教授 関根 智仁
◆カーボンナノチューブ紡績糸を用いた布状熱電変換素子
奈良先端科学技術大学院大学
物質創成科学領域 教授 中村 雅一
◆材料およびデバイスの熱的特性を制御したフレキシブルデバイスの開発
京都大学 大学院工学研究科
マイクロエンジニアリング専攻 准教授 廣谷 潤

11月1日(金)12:35-14:50

E-2 核融合
酒井滋樹(日新イオン機器)/加藤千晴(村田製作所)

◆フュージョンエネルギー実現に向けた学術研究からのアプローチ
核融合科学研究所
フュージョンエネルギー産学連携研究室 室長・教授 安原 亮
◆発電をはるかに凌ぐレーザーフュージョンエネルギー開発
大阪大学 レーザー科学研究所 所長 栄誉教授 兒玉 了祐
◆世界最大級の超伝導核融合実験装置JT-60SAの直流大電流電源
国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構
那珂フュージョン科学技術研究所
トカマクシステム技術開発部 JT-60電源・制御開発グループ
主任技術員 畠山 昭一

11月1日(金)15:15-17:30

E-3 やはり目が離せない！ アジア半導体産業の動き 中・韓・印 アジア半導体産業の最前線を追う！
松下晋司(産業タイムズ社)/戸所義博(イーセップ)

◆中国・インド 半導体産業の現在地
～日本企業にとってチャンスか、脅威か～
㈱産業タイムズ社 代表取締役副社長
電子デバイス産業新聞 特別編集委員 津村 明宏

◆国家総力戦で臨む韓国半導体育成戦略に迫る
～AI半導体の火蓋が噴出する～
㈱産業タイムズ社 ソウル支局長 嚴 在漢